

3EC-III

- 当社3EC-III銅箔は、グローバルスタンダード銅箔として、全世界で高いシェアを有しております。
Global standard copper foil, we have high share in the worldwide market.
- ミドルプロファイルのラミネート面は、高密度な半導体パッケージ基板等にも適しております。
Middle profile in the laminate side, suitable for fine pattern circuit.

用途/Application

- 半導体パッケージ基板
/Semiconductor Package
- 多層プリント配線板
/High Density Interconnect
- フレキシブルプリント基板
/Flexible Print Board

構成/Composition



生産拠点/Production Site

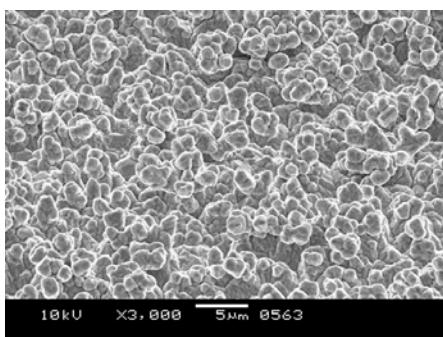
- 日本/Japan
- 台湾/Taiwan
- マレーシア/Malaysia

代表的特性値/Representative date

	μm	Area weight (g/m ²)	Laminate side $R_z(\mu\text{m})$	Tensile Strength (N/mm ²)	Elongation (%)	Peel Strength (kg/cm)@FR-4
3EC-III	12	107	4.5	370	5	1.2
	18	153	5.0	370	8	1.4
	35	285	7.0	370	15	1.9

※表中の数値は代表値です。保証値ではありません。
This is representative date, not guarantee.

ラミ面/Laminate side



レジ面 resist side

